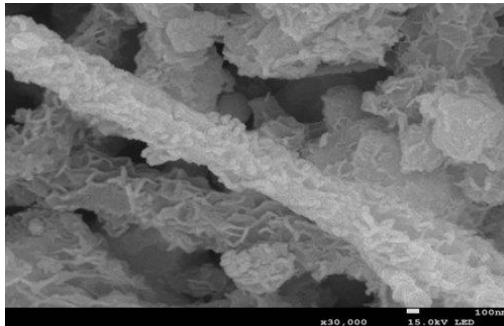


★特徴

・曲げ強度**600～700MPa**、破壊靱性**5-7MPa·m**

(通常のAlN基板の曲げ強度400MPa、破壊靱性2-3MPa·m)

・**窒化ケイ素と同等の強度**を実現



高強度窒化アルミニウム基板は、高熱伝導性と高機械強度を両立した先進セラミックス基板です。従来のAlN基板に比べ、結晶粒制御および焼結助剤の最適化によって破壊靱性・曲げ強度を大幅に向上させています。これにより、高発熱かつ厳しい機械的応力環境においても優れた信頼性を発揮します。

★主な用途

- ・ パワーモジュール（SiC/GaN対応）用放熱基板
- ・ 自動車用インバータ、DC-DCコンバータ
- ・ 高出力LED、レーザーダイオード基板
- ・ 産業用電源モジュール、通信機器
- ・ 宇宙、防衛用途の高信頼性デバイス

★効果・利点

従来の Al_2O_3 基板に比べて熱伝導性と機械的強度が高まることにより、デバイスの小型化・高出力化・長寿命化を可能にし、信頼性の高い電子機器設計に貢献します。また、メタライズやDPCとの高密着性にも優れ、実装プロセスの自由度を高めます。